## (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



## 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 2. Juni 2005 (02.06.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/049312 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: 15/00, 18/00, F01D 5/28, 5/14, F23R 3/00 B32B 5/14,

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HESELHAUS, An-

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP2004/011429

(22) Internationales Anmeldedatum:

12. Oktober 2004 (12.10.2004)

(25) Einreichungsspruche:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 14. November 2003 (14.11.2003) EP 03026281.0

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder, und

dreas [DE/DE]; Birkenstr. 19, 40233 Düsseldorf (DE).

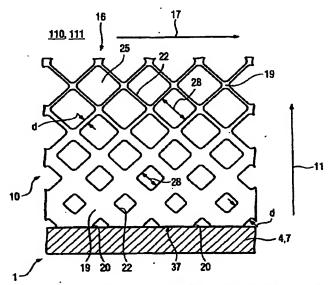
(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: HIGH-TEMPERATURE LAYERED SYSTEM FOR DISSIPATING HEAT AND METHOD FOR PRODUCING SAID

(54) Bezeichnung: HOCHTEMPERATUR-SCHICHTSYSTEM ZUR WÄRMEABLEITUNG UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG



(57) Abstract: Layered systems in prior art are inefficient at cooling an external hot gas. The inventive layered system (1) comprises an external porous layer (10), in which the pore walls (22) of the pores (25) have differing thicknesses. This improves the cooling action by preventing too much heat from entering the layered system (1).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]